

**Dk 4.0 Df 0.013
@10GHz**

Tg(DSC) 170°C

**ハロゲンフリー
鉛フリーはんだ対応**

**用途
ネットワーク**
ICTインフラ機器、計測機器など

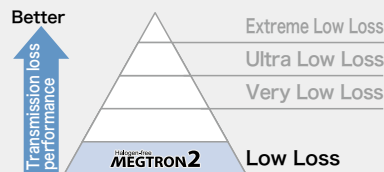


Halogen-free
MEGTRON2

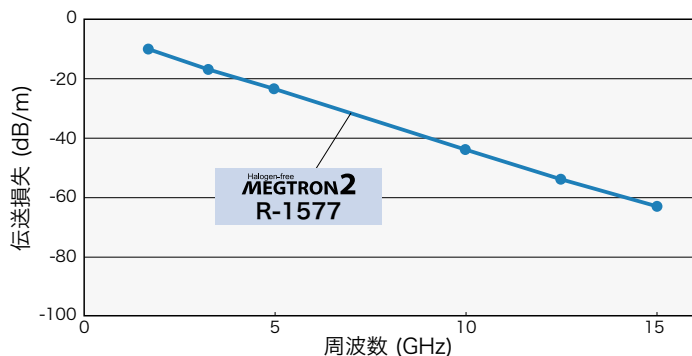
Laminate Prepreg
R-1577 R-1570

**ハロゲンフリー低伝送損失・
高耐熱多層基板材料**

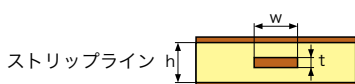
ハロゲン系難燃剤など含まない環境
対応材で、ボリュームゾーンの
サーバ・ルータなどの更なる高速化
に対応



伝送損失比較



構成



回路幅 (w)	0.1mm
回路厚さ (t)	0.035mm
絶縁層厚さ (h)	0.28mm
コア材	0.13mm
プリプレグ	0.06mm x 2ply
回路長さ	1m
インピーダンス	50Ω

高多層耐熱性

評価結果

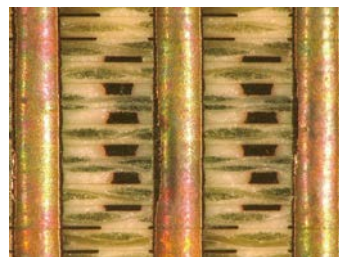
ドリル径	φ0.3mm		
TH壁間距離	0.5mm	0.6mm	0.7mm
Halogen-free MEGTRON2	pass	pass	pass

評価条件

260°Cリフロー×10回

構成

28層
板厚: 3.8mm



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	Halogen-free MEGTRON2 R-1577	
ガラス転移温度(Tg)	DSC	A	°C	170	
熱膨張係数(厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	α1	34
				α2	200
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	25	
比誘電率(Dk)	IPC-TM-650 2.5.5.5	C-24/23/50	-	10GHz	4.0
誘電正接(Df)				0.013	
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	1.3 [ST]

試験片の厚さは0.8mmです。

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。